H10 无卤素免洗焊锡膏

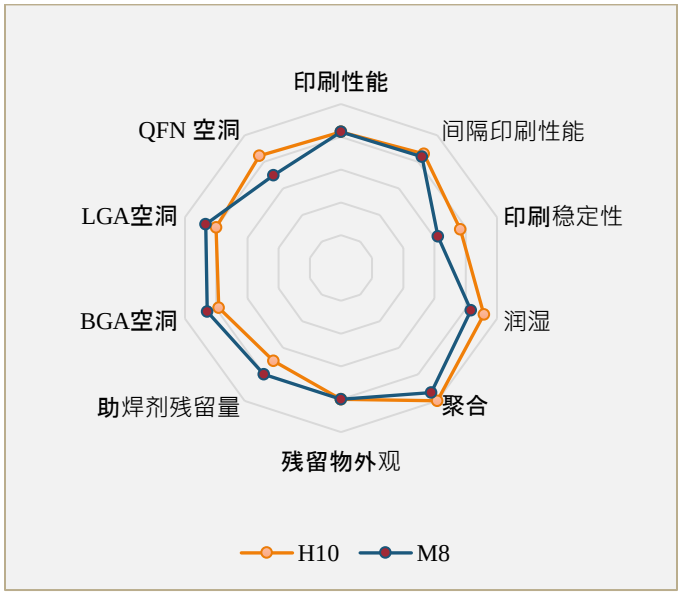
特性

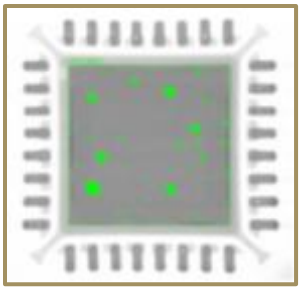
- 零卤素/卤化物
- 优异的润湿性能
- BTC 和 BGA 上低空洞
- 高可靠性
- 配合 T4 合金粉可印刷 0.5 的面积比
- 可提供 T4 和 T5 型合金
- 可提供 SAC305, REL22™, 和 REL61™ 合金

描述

H10 是一款无卤免洗的高性能焊锡膏，具有超强的活性，焊后残留物表面绝缘阻抗高。H10 可使 T4 合金在 0.5 的面积比上的印刷效率大于 90%。其优异的润湿性可消除枕窝（HiP）缺陷，并提升了在各类表面处理后焊盘的覆盖率。AIM 的 H10 减少了 BGA、BTC 和 LGA 上的空洞，并提高了所有卧式元件的电化学可靠性。

特点





处理&储存

参数	时间	温度
冷藏密封保质期	6 个月*	0°C-12°C (32°F-55°F)
非冷藏密封保质期	3 个月*	< 25°C (< 77°F)

*T4 型合金。联系 AIM 获取 T5 型合金的 保质期。

请勿将使用过的焊锡膏添加至未使用过的焊锡膏中。应单独存放；对未使用的焊锡膏，须将内盖或顶盖盖好并重新密封。开封后的焊锡膏保质期取决于环境和应用，详情请见 AIM 焊锡膏使用指导。合金的成分和储存条件可能会影响保质期。请参阅 H10 分析报告中的特定信息。

清洗

回流焊前：使用 AIM 的 DJAW-10 可将钢网上的 H10 焊锡膏清除。DJAW-10 可手动或使用钢网擦拭设备。 DJAW-10 不会使 H10 干燥，但可加强其印刷性能。请勿过量使用 DJAW-10。请勿将 DJAW-10 用于钢网顶部。不建议在工艺过程中使用异丙醇（IPA），但可用于钢网的最后冲洗。

回流焊后残留物：回流焊后 H10 的残留物无需清洗。在必须清洗的情况下，AIM 与行业伙伴合作，共同确保 H10 的残留物可使用普通除焊剂清洗。联系 AIM 以获得清洗兼容性的信息。

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。**有关特定产品的信息，请参阅分析证书。**

负责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 http://www.aimsolder.com/terms-conditions 查询 AIM 相关条款。

WWW.AIMSOLDER.COM INFO@AIMSOLDER.COM

回流曲线

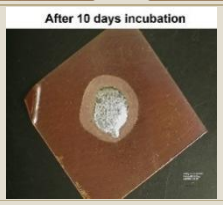
如需获得详细的回流曲线信息，请访问 http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements.联系 AIM 获取更多的信息。

印刷

印刷机推荐的初始设定－取决于 PCB 和 PAD 设计	
参数	推荐初始设定
刮刀压力	0.5–1.0 公斤/25 毫米
刮刀速度	13 – 152 毫米/秒
接触距离	接触 0.00 毫米
PCB 分离距离	0.75 - 2.0 毫米
PCB 分离速度	3 - 20 毫米/秒

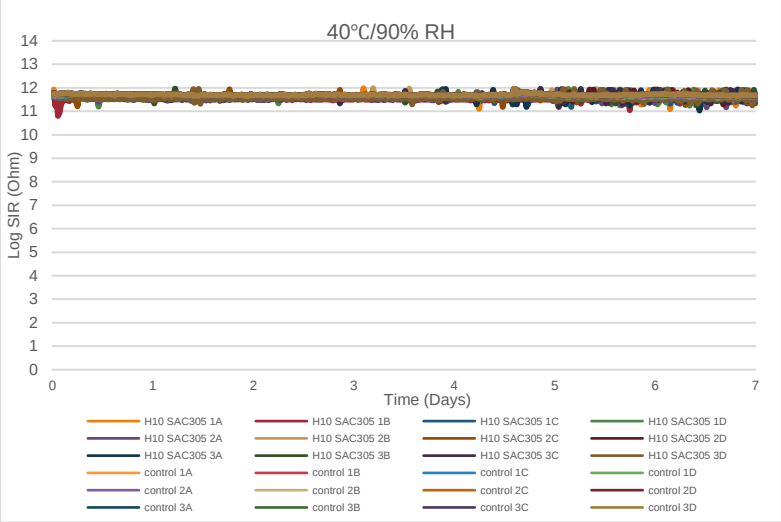
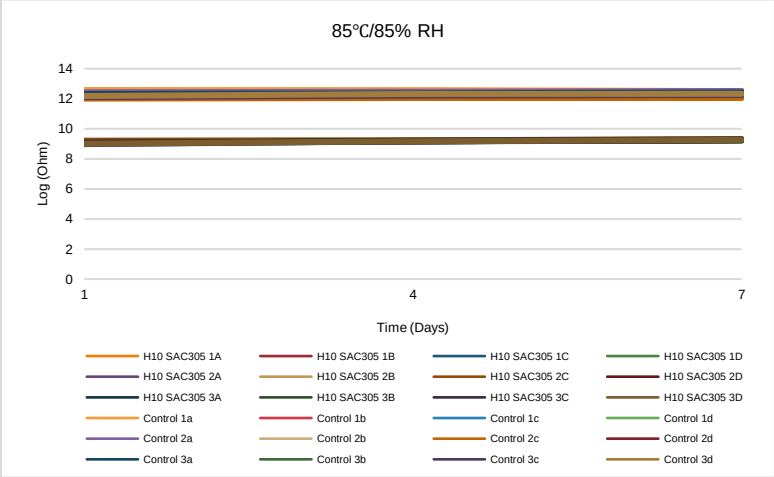
测试数据结论

注: 所有测试数据均适用于 SAC305 T4 配方。

名称	测试方法	结果	
IPC 分类	J-STD-004 B, C 当前版本	ROL0	
名称	**测试方法**	**典型值**	**图像**
铜镜	J-STD-004 Current Rev 3.3.1.1IPC-TM-650 2.3.32 JIS Z 3197:2012 8.4.2	无突破 低 活性	
腐蚀性	J-STD-004 Current Rev 3.3.1.2IPC-TM-650 2.6.15 JIS Z 3197:2012 8.4.1	无腐蚀 低	
定量卤化物	J-STD-004C 3.3.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	<0.05% 低	Cl^- = 0ppm | Br^- = 0ppm | F^- = 0ppm | I^- = 0ppm
定量卤化物，铬酸银测试	J-STD-004 Current Rev 3.4.1.1IPC-TM-650 2.3.33 JIS Z 3197:2012 8.1.4.2.4	通过	
定量卤化物、氟化点	J-STD-004 Current Rev 3.4.1.2IPC-TM-650 2.3.35.1	通过	
卤素含量	J-STD-004 Current Rev 3.4.4 IPC-TM-650 2.3.28.1 EN 14582	通过	无卤素

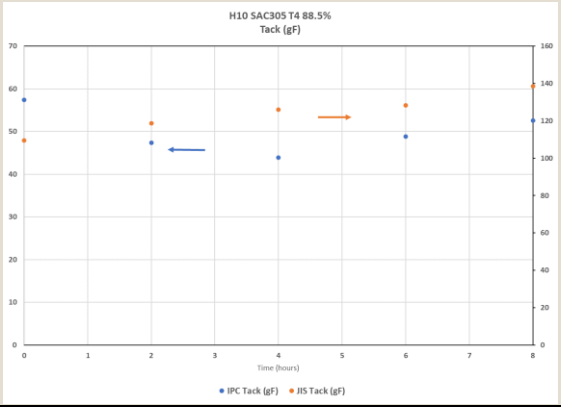
*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。**有关特定产品的信息，请参阅分析证书。**

负责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 http://www.aimsolder.com/terms-conditions 查询 AIM 相关条款。

名称	测试方法	典型值	图像
表面绝缘电阻	J-STD-004C 3.3.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	未清洗的状态下 ≥ 100 MΩ 低	
表面绝缘电阻	J-STD-004B 3.2.4.5 IPC-TM-650 2.6.3.3b	通过	
抗电迁移	BELLCORE GR-78-CORE Issue 2200713.2.7	通过	
助焊剂固体含量、非挥发性测定	J-STD-004C 3.3.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	74% 固含量	
酸值	J-STD-004 Current Rev. TM-650 2.3.13	174.2 mg KOH/g	
粘度 (Malcom)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	150-250 Pas 典型值 (SAC305 T4)	
外观	J-STD-004C 3.3.2.5	通过	
坍塌测试	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	通过	

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。**有关特定产品的信息，请参阅分析证书。**

负责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 http://www.aimsolder.com/terms-conditions 查询 AIM 相关条款。

粘度	JIS Z 3284 2.4.44 IPC-TM-650		

*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。**有关特定产品的信息，请参阅分析证书。**

负责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 http://www.aimsolder.com/terms-conditions 查询 AIM 相关条款。